

ウェーハー／フィルム貼り付け装置

高性能ダイシング工程周辺機器

High Performance Peripheral Devices for Dicing Processes

WAFER MOUNTER

TECHNOVISION, INC.



バックエンドプロセスの自動化、省力化に大きく貢献

Practical improvements to back-end processes via automation and labor-savings

FM-224 MANUAL WAFER MOUNTER SERIES

FM-224 マニュアル・マウンターシリーズ



● 特長

- ・ウエーハーとフィルム間に気泡を入れずに瞬時に貼り付け作業ができる
- ・余分なフィルムを切り離す水平カッター、円周カッターを搭載
- ・フィルム保護シート(セパレーター)自動巻取り機構付き
- ・150mm(6")200mm(8")300mm(12")の3機種を用意
- ・シンプルメカ、メンテナンスフリー

● Features

- Quick mounting without air bubbles
- Equipped with horizontal and circular cutters to remove unused film
- Automatic take-up of separator film
- Available in three size, 150mm(6" inch), 200mm(8" inch), 300mm(12" inch)
- Simple and Maintenance-free design

■ ダイシング工程用

ダイシングフレーム/ウエーハーとフィルムの貼り付け作業が素早く出来ます。全ての種類のダイシングフレームに対応できます。特殊カッターによりフィルムのスムーズなカットができ、ダイシングフレームのキズを最小におさえます

FOR DICING PROCESS

For rapid mounting of dicing frames, wafers, and film. Suitable for all types of dicing frames. Specially-designed cutters cut the film efficiently with minimal damage to dicing frames.

■ バックグランド用/保護フィルム貼り付け用

本フィルム貼り付け装置はウエーハーパターン面保護用または、裏面の保護用としてのフィルム貼り付けに有効です。また、特殊カッターによりウエーハー外周に沿ってフィルムカットが可能です

FOR BACK GRINDING / SURFACE PROTECTION

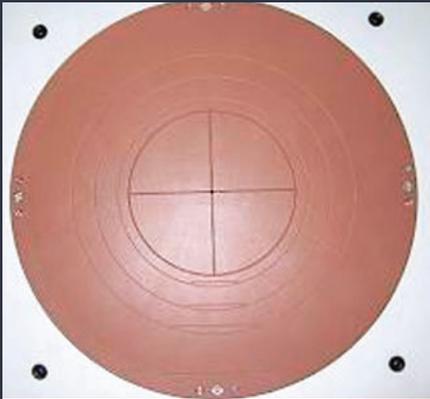
This model helps you mount film on a wafer to protect both pattern sides and backsides. Can also be used to cut film accurately around the wafer perimeter using a specially designed cutter.

上記で紹介した他にダイボンドフィルム対応機種、2種のフィルムを同時に搭載できる機種等もございます。詳しくはお問い合わせください。

Other models are available including mounters for die bonding film, mounters that accommodate 2 differing kinds of film, etc. For details, contact Technovision.

■ カスタム例

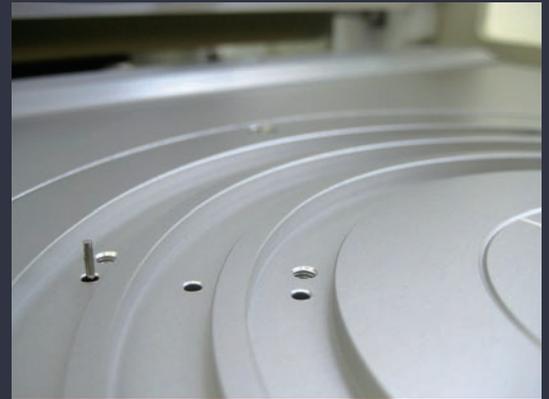
Excellent application and customizing



通常チャック
Normal Chuck



4"5"6"兼用BGチャック
4"5"6" Combined BG Chuck



位置決めピン
Positioning Pins



中空(非接触)チャック
Non-Contact Chuck



角型ワーク用チャック
Chuck for Square Work



静電気除去ユニット(オプション)
ESD Unit (Option)



大型リッド用ダンパー(オプション)
Shock-Absorber (Option)



ヒーターユニット
Heater (Hot Stage) Unit

【ご注意点】

オプション追加や改造・仕様変更に伴い必要になるユーティリティが変化しますので詳細はお問い合わせください。

尚、仕様によっては組み合わせのできないオプションもあります。

【 Please Note 】

Options and customization may require utility changes, therefore contact Technovision for details.

Some options cannot be combined in the same product because of specifications.

■ 標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS

仕様	機種	FM-2246	FM-2248	FM-2243
ウエーハサイズ(最大) Wafer Size (Max.)		φ150 6" inch	φ200 8" inch	φ300 12" inch
フィルム幅(最大) Film Width (Max.)		230	300	410
装置サイズ(巾×奥行×高) Dimension (W×D×H)		375x760x230	455x780x300	510x860x330
装置重量 Weight		25kg	28kg	32kg

使用電源・周波数はご利用になる地域・国に合わせて製造します。

Voltage and frequency are matched to your country and factory.

生産管理の改善、歩留り向上に貢献

Contributing to improved production control and higher yields

FM-3343 SEMI-AUTOMATIC WAFER MOUNTER

300mm 対応
FM-334
セミオート・マウンター



各種フィルムの貼付けを常に最適の状態で行う半自動装置です。機能、操作性、ラミネーションのリピータビリティ等、あらゆる面で性能が向上しました。オペレーターを選ばない安定した作業、フィルムごとに貼付け条件の定量化等、多様化するお客様のニーズを満たした製品の提供をお約束いたします。

This semi-automatic wafer mouter optimizes film lamination. It improves performance in all ways: quality, operability and lamination repeatability. It promises to meet diversifying customer demands for stable operation that does not require special skills, film-specific numerical control over lamination conditions, etc.

- **ダイシングフィルム貼付け For Dicing**
- **ダイボンド／ダイアタッチフィルム貼付け For Die-Bonding / Attaching Film**
- **保護フィルム貼付け For Front / Back side Protection**

● 特長

- ・ 貼付け条件の数値管理が出来る
- ・ モーター駆動方式貼付けローラーシャトル機構
- ・ 貼付スピード可変設定
- ・ 貼付け圧力可変設定
- ・ 中空 (非接触) チャック対応可能
- ・ アタッチメントの交換で多機能用途に対応
(ダイシング、DAF、BG、ウエハーサイズの変更も1台で可能)

● Features

- ・ Numerical management of lamination conditions.
- ・ Film roller system is automatically shuttled with a motor-drive.
- ・ Adjustable speed in film lamination.
- ・ Adjustable pressure in film lamination, with automatic film roller system.
- ・ Available with non-contact chuck for film lamination
- ・ Fit for multi-purpose applications via replaceable attachments (Single machine for dicing, DAF, BG and differing wafer sizes.)

標準仕様 STANDARD SPECIFICATION

仕様	機種	FM-3343
ウエハーサイズ (最大) Wafer Size (Max.)		φ300 12" inch
フィルム幅 (最大) Film Width (Max.)		410
装置サイズ (巾×奥行×高) Dimension (W×D×H)		525x940x415
装置重量 Weight		55kg



オペレーターの作業はウエーハーとフレームを置くだけ。
取り出すまでの作業は903Sにお任せください。

The operator merely has to set wafer/dicing frame and then remove the finished work. The Model 903S, other than loading and unloading, Will do the rest or the process automatically.

FM-903S SEMI-AUTOMATIC WAFER MOUNTER

FM-903S
セミオート・マウンター



● 特長

- ・ウエーハー/フィルム/フレームの貼付け作業が安定して行えます
- ・熟練したオペレーターの必要がありません
- ・ウエーハーとフィルムの上に気泡が入りません
- ・余分なフィルムをスマートにカットできます
- ・フィルムの保護シートを自動的に巻き取ります
- ・ローラーとステージの自動平行機能
- ・貼付けスピード調整可
- ・フィルムのカット調整可
- ・ローラーの圧力調整可
- ・機能性、操作性に優れたタッチパネル
- ・フィルムカット自動チェック機能
- ・フィルムエンドの表示機能
- ・セーフティインターロック機能

● Features

- Repeatable and robust lamination processing of the wafer/Film/dicing-frame.
- No skilled operator necessary
- Bubble free process
- Clean cutting of remained film
- Automatic take up of protective film sheet
- Automatic adjustment of parallelism between roller and stage
- Adjustable lamination speed of film
- Adjustment of film cutting speed with easy
- Easy adjustment of roller pressure
- Touch panel with excellent functionality and controllability
- Automatic monitoring function of film cutting
- Automatic notice of "end of film"
- Safety interlock functions where required

本装置はウエーハー移載ロボットを付けて“カセット to カセット”全自動装置への対応が可能で生産数が増えた場合の対応が迅速に行えます。

With a wafer handling robot, a fully automatic "Cassette to Cassette" system available. The system can respond promptly to required production increases.

■ 標準仕様

STANDARD SPECIFICATION

仕様	機種	FM-903S
ウエーハーサイズ (最大) Wafer Size (Max.)		φ200 8" inch
フィルム幅 (最大) Film Width (Max.)		300
装置サイズ (巾×奥行×高) Dimension (W×D×H)		1,000x600x800
装置重量 Weight		150kg

プリカット／ノーマルテープに対応。 1台2役 セミオート・マウンターのハイエンド機種

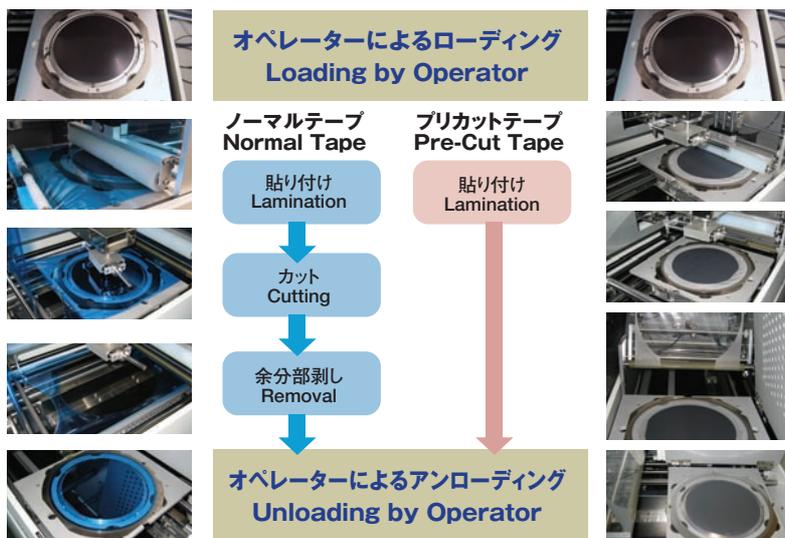
For both pre-cut and normal tape
2-in-1 high-end semi-automatic wafer mounters

FM-664 SEMI-AUTOMATIC WAFER MOUNTER SERIES

FM-664 シリーズ・セミオート・マウンター



FM-903Sの優れた操作性に1台2役の新たな機能を追加しました
New features to enable 2-in-1 performance were added to the prized operability of the FM-903S.



● 特長

- ・プリカットテープ、ノーマルテープの両方に対応
- ・オペレーターの作業はワークのロード／アンロードのみ
- ・表面非接触貼付け対応可
- ・ヒーター及び静電気除去装置内蔵
- ・200mm(8" inch)/300mm(12" inch)対応の2機種を用意

● Features

- ・ Available for both pre-cut and normal tape
- ・ Semi-automatic system. Operator needs only to load and unload wafers/tapes.
- ・ Available with non-contact chuck for film lamination
- ・ Built-in electrostatic eliminator and heater
- ・ Available in two size, 200mm(8" inch), 300mm(12" inch)

標準仕様

STANDARD SPECIFICATIONS

仕様	機種	FM-6648	FM-6643
ウエーハーサイズ(最大) Wafer Size (Max.)		φ200 8" inch	φ300 12" inch
フィルム幅(最大) Film Width(Max.)		300	410
装置サイズ(巾×奥行×高) Dimension (W×D×H)		1,220x660x1,620	1,710x975x1,570
装置重量 Weight		200kg	450kg

- ★ プリカット(Pre-Cut)
- ★ ダイシングテープ(Dicing)
- ★ DAF/ダイシング一体型テープ (DAF/Dicing tape)
- ★ DAF単体テープ (DAF tape)
- ★ 機能性テープ各種 (All functional tapes)
- ★ BGテープ (BG tape)



株式会社 テクノビジョン
TECHNOVISION, INC.

〒350-0165 埼玉県比企郡川島町中山2078
電話 049-299-1385
FAX 049-299-1386

<http://www.techvision.co.jp> E-mail: technovision.info@techvision.co.jp